

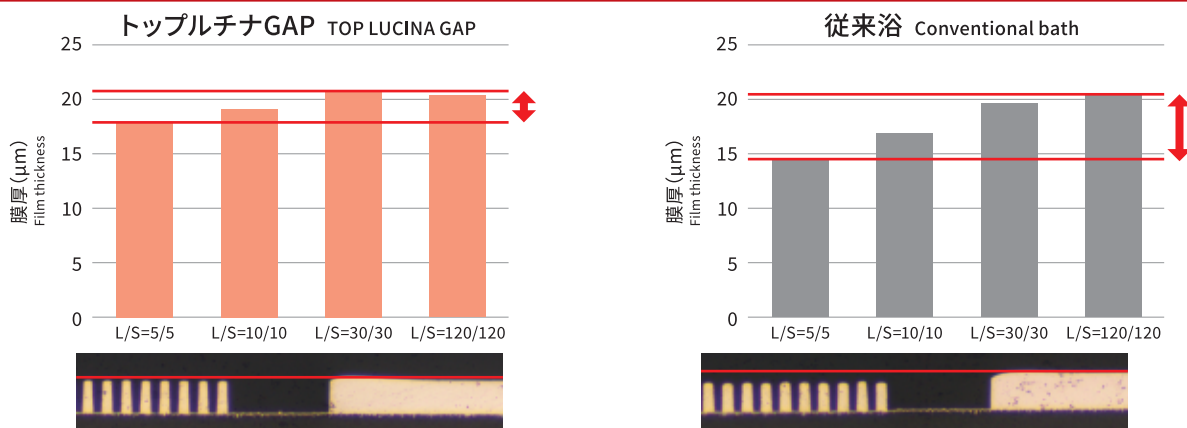
ファインパターン対応 ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤
Additives for Acid Copper Plating For Via-filling Applicable to Fine Pattern

トップルチナGAP

TOP LUCINA GAP

- パターンの幅や疎密にかかわらず、めっき膜厚の均一性に優れる
Regardless of pattern size/density, uniform thickness is available
- 大口径ビアホールへのフィリングに対応
For filling large-diameter via-holes
- スルーホールフィリング対応
Applicable to through-hole filling
- 幅広い電流密度でビアフィリングが可能
Can make via-filling in wide current density areas

配線幅間の膜厚のばらつきが小さい Small thickness variation between patterns

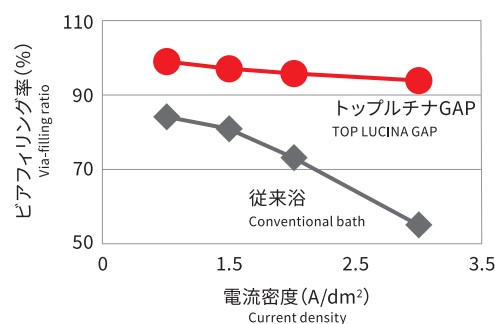


トップルチナGAPと従来浴の膜厚の比較 (L/S=5/5)
Comparison of thickness between TOP LUCINA GAP and conventional bath

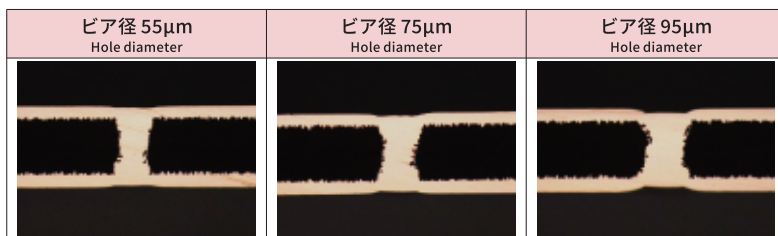
様々なビア径に対して高いフィリング性を実現 High filling performance is available to various via-diameter

ビア径 (μm) Hole diameter	膜厚 (μm) Thickness	トップルチナGAP TOP LUCINA GAP	従来浴 Conventional bath
60	5		
80	7		
110	12		

幅広い電流密度に対応 Applicable to wide current density



スルーホールフィリング性を実現 Realize through-hole filling



表層膜厚 18μm
Surface thickness